



Produktliste Bleifrei-Lotpaste in Kartuschen von Koki

Koki ist weltweit bekannt für seine technische Unterstützung, Produktentwicklung und Lieferketten-Organisation. Seit der Gründung 1964 werden High-Tech-Produkte für die Lötindustrie hergestellt. Koki entwickelt laufend neue Technologien, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Die folgenden Standardlegierungen von bleifreier Lotpaste repräsentieren nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm. Sollte die von Ihnen benötigte Legierung nicht aufgeführt sein, senden Sie uns bitte eine Anfrage.

S3X58-M406-3 **Bleifrei-Lotpaste No-clean mit Anti-Kissen-Effekt**

Verhindert das Auftreten von versteckten Kissenwirkungen und sichert die Qualität der Lötstellen. Sorgt für eine hervorragende kontinuierliche Bedruckbarkeit mit Super-Fine-Pitch und CSP-Anwendungen und ermöglicht eine lange Schablonenruhezeit. Mit der neuen hitzebeständigen Flussmittelformel gelingt die vollständige Lotschmelze und Benetzung der Mikrokomponenten. Es ermöglicht eine einheitliche langfristige Bedruckbarkeit durch die Verhinderung des Viskositätsabfalls. Viskosität (Pa.S) 210 ± 10%.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Kartusche à		Schmelztemp.
1057	S3X58-M406-3	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	150 ml	0.60 kg	217° - 218°C
2350	S3X58-M406-3	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	300 ml	1.20 kg	217° - 218°C

S3X58-M500 **Bleifrei-Lotpaste No-clean für die Anwendung in Druckschablonen**

Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine drastische Reduktion des Voidings bei Komponenten mit grosser Kontaktfläche zu erzielen, wie z. B. bei Leistungstransistoren, QFN und vor allem bei automatisierten Anwendungen. Anti-Kissenwirkung-Formel. Kraftvolle Benetzung. Sichert gleichbleibende Qualität und Leistung bei Dauereinsatz über mehrere Tage. Sehr sparsam in der Anwendung. Halogenfrei (Br ≤ 900 ppm, Cl ≤ 900 ppm, Br + Cl ≤ 1500 ppm). Die Lotpaste ist geeignet für superfeine Muster, MBGA, 0.4mm QFP, QFN.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Kartusche à		Schmelztemp.
2355	S3X58-M500	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	300 ml	1.20 kg	217° - 219°C

S3X58-M500C **Bleifrei-Lotpaste No-clean für Leistungsstarke Benetzung + Anti-Kissenwirkung**

Im heutigen SMT-Bereich haben sich die Anwendungen und Arten der Leiterplatten erhöht. Die Lötbedingungen werden den verschiedenen Oberflächen und der Qualität des Basismetalls angepasst.

Oxydierte Komponenten sind als Verursacher vieler Lötfehler ein großes Problem.

Sorgt für eine hervorragende kontinuierliche Bedruckbarkeit mit Super-fine-pitch (0.4mm/16mil) und CSP Anwendungen (>0.3mm dia.) für normales bis schnelles Drucken und einer langen Schablonenleerlaufzeit. Leistungsstarke Benetzung oxydierter Unterlagen und Komponenten wie z. B. oxidiertem Nickel. Ultimative Lösung für die Entnetzung.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Kartusche à		Schmelztemp.
2355-C	S3X58-M500C	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	300 ml	1.20 kg	217° - 219°C



S3X58-M406D **Bleifrei-Lotpaste No-clean für allgemeine Dosiersysteme**

Diese Lotpaste besteht aus einer Kombination von binären eutektischen Legierungen aus Zinn und Silber, welche halogenfrei ist. Das No-clean-Flussmittel ermöglicht eine Lötleistung und Benetzbarkeit, welche herkömmlichen No-clean-Lotpasten entspricht. Die Sorgfältig ausgewählte Flussmittelchemie sorgt für einzigartig niedrige Hohlräume und eine leistungsfähige Lot-Benetzung. Es hat eine extrem hohe Zuverlässigkeit. Die extrem lange Klebrigkeit bietet ein breites Verarbeitungsfenster. Die Flussmittelrückstände sind farblich unauffällig, was eine überlegene optische Erscheinung bietet.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Kartusche à		Schmelztemp.
2296	S3X58-M406D	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	30 ml	0.12 kg	217° - 218°C
1031	S3X58-M406D	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	10 ml	0.04 kg	217° - 218°C
1131	S3X58-M406D	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	4	ROLO	5 ml	0.02 kg	217° - 218°C

S3X70-M500D **Bleifrei-Lotpaste No-clean für Dosiersystem-Anwendung**

Halogenfrei, 14 % Flussmittel, Partikelgrösse nur 10-25 µm

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Kartusche à		Schmelztemp.
1141	S3X70-M500D	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	5	ROLO	10 ml	0.04 kg	217° - 219°C

S3X811-M10D-2 **Bleifrei-Lotpaste No-clean für Dosiersystem-Anwendung**

Halogenfrei, Partikelgrösse nur 5-20 µm, für superfeine Musteranwendungen.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Kartusche à		Schmelztemp.
1145	S3X811-M10D	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	6	ROLO	10 ml	0.04 kg	217° - 218°C

Lieferzeiten auf Anfrage oder im E-Shop ersichtlich

Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter können Sie per Mail bei uns anfordern.

21.08.2015 is